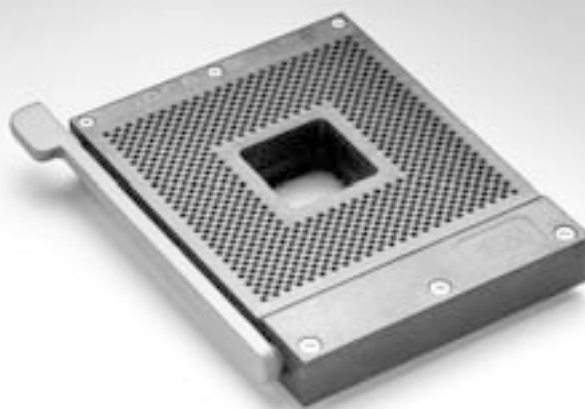


IPGA

Textool™ Sockets For Test and Burn In

IPGA ソケット 1357タイプ (23×23グリッド)

- 2.54mmピッチ千鳥格子のPGA パッケージに適合
- ゼロ挿抜力機構により、リードの損傷を防止
- 2点接触方式により、高い接触信頼性を実現
- 最大23×23グリッド、792ピン対応
- 2種類の適合リード径を用意



製品仕様

材料及び処理

ボディ	ガラス入りPES樹脂	UL94V-0、色調:黒
コンタクト	ベリリウム銅	ニッケル下地金メッキ
カムレバー	アルミ合金	
スクリュー	ステンレス鋼	No.0-80 UNF
スクリュー	ステンレス鋼	サラハネジM2.0
ストッパー	ステンレス鋼	

定 格

定格電流	1.0A MAX.(25°C)
使用温度	-55°C~+150°C

適合対象

適合パッケージ	適合基板 (推奨)
以下の仕様のIPGAパッケージと適合する。	基板厚 1.6mm
リード径	スルーホール径 $\phi 0.6\text{mm Min.}$
リード長	
リード数	
リード表面処理	

※ / パッケージリードにスタンドオフが設けられている場合は、スタンドオフ下部からリード先端部までをリード長とする。

関連規格

MIL-STD-202F, UL94V-0

機械的特性

開閉耐久性	開閉回数 3,000回 (常温)
-------	------------------

電気的特性

耐電圧	AC500V RMS 1分間
絶縁抵抗	500M Ω 以上 (DC500V)
接触抵抗	初期値 25m Ω 以下 (1.5mA)

IPGAソケット1357タイプ(23×23グリッド)

オーダーインフォメーション

2XXX-1357-□□-1902

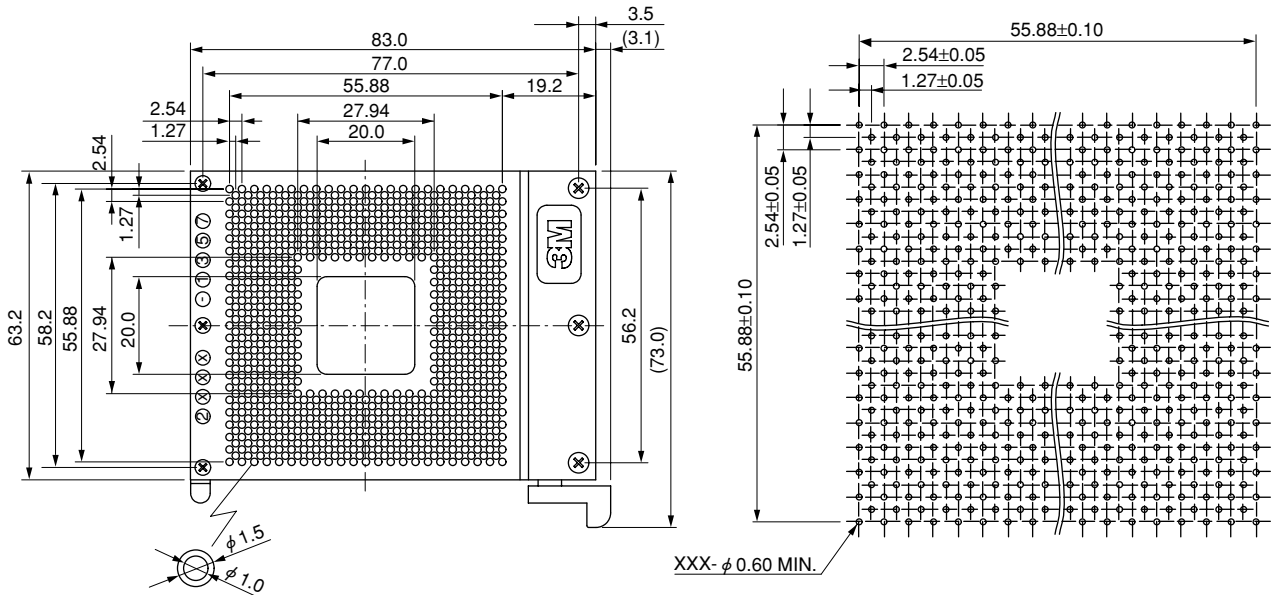
適合リード径 (mm)
 00: $\phi 0.25 \sim \phi 0.40$
 50: $\phi 0.35 \sim \phi 0.51$

コンタクト数 (最大792ピン)

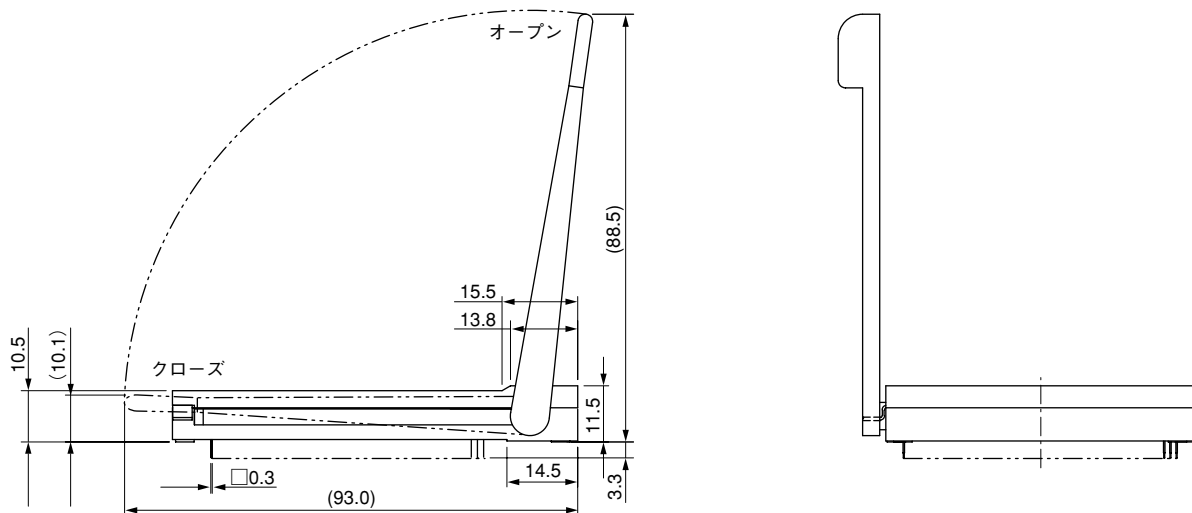
●IPGAソケットは標準のピン配列はございません。

オーダーの際は、ピン数、ピン配列、リード径等の指定を、D-11 ページに掲載されているワークシートにご記入下さい。

IPGAソケット1357タイプ(23×23グリッド)



PCB ホールパターン参考図 (ソケット実装面側)



指定外寸公差

寸法	.0	.00
公差	±.3	±.13

単位: mm

※ ZIP (Zero Insertion Pressure) ソケットを基板へハンダ付けする作業は、コンタクトをオープン状態にして行って下さい。